PREPARATION OF METAL MATRIX MOLD FOR DUPLICATING PLATE **BODY HAVING RECESSED AND PROTRUDED INFORMATION**

Publication number: JP58217689 (A) Publication date:

1983-12-17

Inventor(s):

WATANABE TAKESHI; SUDOU RIYOUICHI; OKUDAIRA HIROAKI: NAKAMURA

SHIGEMI; MIWA HIROAKI

Applicant(s):

HITACHI LTD

Classification:

- international:

G11B23/30; C23C18/34; C25D1/10; G11B23/18; G11B23/30; C23C18/31;

C25D1/00; G11B23/18; (IPC1-7): C25D1/10; G11B23/18

- European:

Application number: JP19820099394 19820611 Priority number(s): JP19820099394 19820611

Abstract of JP 58217689 (A)

PURPOSE:To obtain the titled metal matrix mold, by a method wherein the nucleus of an activating metal is formed on the sensitized and activated surface of resin and electroless plating of Ni and Co is applied to the treated surface of resin to form a conductive film for electroless plating. CONSTITUTION: The nucleus of an activating metal is formed on the sensitized and activated surface of resin and Ni or Co is subsequently applied to the activated surface at an almost room temp. by electroless plating to form a conductive film for electroless plating. Ni electrolytic plating is further applied to obtain a metal body. This metal body is separated at the interface with the activated surface to form a negative matrix mold with a recessed and protruded information pattern.

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58-217689

⑤Int. Cl.³
C 25 D · 1/10
// G 11 B 23/18

識別記号

庁内整理番号 7325—4K 7177—5D ③公開 昭和58年(1983)12月17日発明の数 1

審查請求 未請求

(全 5 頁)

砂凹凸状情報を有する板状体の複製用金属母型の製法

@特

願 昭57-99394

22世

願 昭57(1982)6月11日

⑩発 明 者 渡辺猛志

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究

所内

仍発 明 者 須藤亮一

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内 仰発 明 者 奥平弘明

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

⑩発 明 者 中村成身

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

個代 理 人 弁理士 中村純之助

最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称 凹凸状情報を有する板状体の 複製用金属母型の製法

2. 特許請求の範囲

(2) 特許請求の範囲第1項に記載の凹凸状情報 を有する板状体の複製用金属母型の製法において、 無電解メッキを完全な金属鏡面の得られる前段階で停めるととを特徴とする凹凸状情報を有する板 状体の複製用金属母型の製法。

- (3) 特許請求の範囲第1項に配載の凹凸状情報を有する板状体の複製用金属母型の製法において、 紫外線硬化性樹脂が炭素-炭素二重結合を有する 有機材料であることを特徴とする凹凸状情報を有 する板状体の複製用金属母型の製法。
- (4) 特許請求の範囲第1項紅配載の凹凸状情報を有する板状体の複製用金靏母型の製法において可溶性樹脂がセルロース系高分子物質であることを特徴とする凹凸状情報を有する板状体の複製用金属母型の製法。
- (5) 特許請求の範囲第1項に記載の凹凸状情報を有する板状体の複製用金属母型の製法において可溶性樹脂が、アセチルセルロース、エチルセルロース、メチルセルロース、プロピルセルロース からなる樹脂であることを特徴とする凹凸状情報を有する板状体の複製用金属母型の製法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、ビデオディスクや光ディスクメモリ あるいは溝あり静電容量方式ビデオディスク用ス タイラスの針先研磨皿等の凹凸状情報を有する板 状体の複製用金属母型の製法に関するものである。

上述した方式においては、通常、ニッケル被膜 を被着するための前処理として、表面を適当に活

凹凸状情報を有する板状体の複製用金属母型の製法を提供するにある。本発明は、上記目的を達成するため、母型となるニッケル被膜を、まず樹脂表面を増感活性化してその表面に活性化金属の複を形成し、次にこの活性化された表面に抵ぼ室温でニッケルまたはコパルトを無覚解メッキして電解メッキ用導電膜を形成し、さらにニッケル電解メッキを行うことによって作成することを要点とするものである。

まず、本発明の基礎となる事項を総括的に説明する。上述した従来技術の欠点は、ほぼ空温におけるニッケルまたはコバルトの無電解メッキ用導電性基層となすことににり解消される。このほぼ空温となけるニッケルまたはりによる特公昭49 - 47615号公報に配飲にになら特公昭49 - 47615号公報に配飲になれている手法を採用することができる。同公報に配収になりて登温におけるニッケルまたはコバルトの無電解メッキ法は、被着体が、アルカリ性媒体によって侵されやすい形態の合成樹脂質の正のホト

性化した後、化学的還元法により銀の薄層を形成 して導電性基層を作成する。次に、基層上にニッ ケルを電気メッキし、適当な厚さにニッケル層を 形成した後、この構体を銀層とラッカー基層との 界面で分離する。との方法では、通常、銀層表面 を硬化するために、銀表面にニッケルおよび/ま たはクロムを被着するか、あるいは銀層をエッチ ング除去して硬質なニッケル面を露出させる。そ のため、この面は原樹脂面を完全に忠実には再現 せず、原記録に若干の劣化をきたすという欠点が 生じる。そとで、上記の欠点を除去するために、 導電性基層をニッケル等の金属の蒸着によって形 成する方法が考えられる。この方法は、パターン の凹凸が小さい場合には好適であるが、梁溝や梁 いピットや高い突起を有する一般の場合は、溝や ビットおよび突起の側面の金属膜の付着が少なく なり、電気メッキ中に断線を生じたり、側面形状 が不正確になるという欠点がある。

本発明の目的は、上述したような従来技術の欠点をなくし、正確に原情報パターンを転写し得る

電解メッキ用導電性基層をニッケルまたはコバルトのほぼ室温における無電解メッキ法によって形成する際に問題となるのは、大きなメッキ応力である。例えば、CBSソニー社による特公昭 53 ー 26482号公報に記載の実施例のごとく、無電解ニッケルメッキ法によって 0.4 ~ 0.8 µ厚まで導電性基層を形成しようとすると、特に平坦部分において、無電解メッキ時あるいは後段の電解メッキ時に、付着金属膜にクラック、剥離が生じる

しかし、ニッケルまたはコバルトの無電解メッキ は、完全に金属鏡面が得られ不透明化する前段階 で停めることにより、適用できることが判明した。 すなわち、図面は、直径30 cmのアクリル基板坦 体上の紫外線硬化性樹脂面に、半径 3 cm の位置 から半径 8.5 cm の位置まで、深さ 5 μm 、幅 2 итの帯を10 итのピッチでら旋状に刻んだパタ ーンの陰像を転写した基体に無電解メッキによっ てニッケル膜を付着させた場合の、内外期間抵抗 の無電解メッキ時間依存の一例を示したものであ るが、完全に金属鏡面が得られ不透明化した抵抗 **域るでは、無電解メッキ時あるいは次工程の電解** メッキ時に、平坦部の付着金銭額にクラックおよ び剥離が生じた。また、抵抗城1では、後段の電 解メッキ時に断線が生じた。従って、この場合の 好適な抵抗値は20gから1kgの範囲であったが、 との値は転写しようとする凹凸状の情報パターン の形状によって変化するものであり、特定すると とはできない。つまり、凹凸状の情報パターンの 形状が変化しても共通していえることは、完全に

$$Na P_2 O_7 \cdot H_2 O$$
 17 g/ ℓ (CH_5) $_2 NHBH_5$ 0.5 g/ ℓ pH($\tau \nu$ モニア調整) 10.3

上記により得られた導電性基層は、半透明で完全な金属鏡面とはなっていない。内外関間の抵抗は約30℃であった。次に、スルファミン酸ニッケル溶で電解ニッケルメッキを行い、ニッケルを0.25mm被着させた。答温は30℃、pHは4.0初期電流密度は0.03アンペナ/dm²である。

・〔 実施例2〕

ガラス基板に半径3cmの位置から14cmの位置まで情報ピットおよびガイド帯を形成した光ディスクピデオレコード原盤から、大日本インキ化学社製の紫外線硬化性樹脂 HSD-1 を用いて、ガラス基板坦体上に情報パターンを転写させた。 これに、実施例1と同様に、親水化処理、増感処理、活性化処理を行った。次に、室温用ニッケル 金属鏡面が得られ不透明化する前段階で無電解メッキを停めることが好ましいということである。 とのような状態の導電性基層であっても、後段の 電解メッキを行った後には、良好な転写面が得られる。

以下、本発明の実施例について説明する。 〔実施例1〕

ガラス原盤に、半径3 cmの位置から 14 cmの位置まで、深さ5 μm、幅2 μmの溝を10 μm ピッチでら旋状に弱んだパターンを、大日本インキ化学社製の紫外線硬化性樹脂 HDS - 1 を用い、アクリル基板坦体上に転写せしめた。これを30 5 HNO3 溶液に浸漬して親水化処理を行った後、塩化スズ増感溶液への浸漬、および塩化パラジウム活性化溶液への浸漬を行った。次に、室温用ニッケル・ホウ素型無電解メッキ溶(溶温30 ℃)に4分間浸渍して電解メッキ溶の組成は次のとおりである。

NiSO4 · 6H2O

8.3 g/l

リン型無電解メッキ溶(溶温 30 ℃)に 3 分間 受演して電解メッキ用導電性基層を形成した。と の室温用無電解メッキ器の組成は次のとおりである。

Ni $C\ell_2 \cdot 6H_2O$ 7. 1 g/ℓ Na H_2 PO 2 · H_2 O 8. 3 g/ℓ Na $_4$ P2 O7 · $_10H_2$ O 17 g/ℓ NH $_4$ OH (58 wt. 多数) 3. 5 cc/ ℓ

上記により得られた導電性基層は、半透明で完全な金属鏡面にはなっていない。内外周間の抵抗は約800 gであった。次に、実施例1 と同様に、電解ニッケルメッキを行い、樹脂面からニッケル面を分離し、情報パターン形状を観察したところ、ガラス原盤の情報パターン形状に正確に対応する情報パターンが得られていた。

〔実施例3〕

ガラス基板に半径 4 cm の位置から 14 cm の位置まで情報ピットおよびガイド帯を形成した光ディスクメモリ原盤に、アセチルセルロース、エチルセルロース、プロビルセル

ロース、プチルセルロースの溶液を各個に塗布し、それぞれ溶剤乾燥後、大日精化社製の紫外線硬化性相脂 E - 15 を接着剤として、ガラス基板退休上に情報パターンを転写させた。これに、実施例1と同様に、親水化処理、増感処理、活性化処理を行った。次に、室温用無電解コバルトメッキ溶(溶温 30 ℃)に5 分間浸漬して電解メッキ溶電性基層を形成した。この室温用無電解メッキ溶の組成は次のとおりである。

$$Na_4 P_2 \cdot O_7 \cdot 10 H_2 O$$
 12 g/ ℓ Co SO₄ · 7 H₂O 9. 1 g/ ℓ NH₄ OH (58 wt. %故) 1. 3 cc/ ℓ (CH₃)₂NHBH₃ 0. 3 g/ ℓ

上配により得られた導電性基層は、半透明で完全 な金属鏡面にはなっていない。内外周間の抵抗は 約60 g であった。次に、実施例 1 と同様に、電 解メッキを行い、樹脂面からコバルト面を分離し、 情報パターン形状を観察したところ、ガラス原盤 の情報パターン形状に正確に対応する情報パター ンが得られていた。

ック、剥離が生じた。また、無電解ニッケルノッキ答の浸漬時間を 15 分間にしたところ、この時点で、平坦部のニッケル膜にクラック、剥離が生じていた。これらの電解メッキ用導電性基層は完全な金属鏡面状態であった。

上述したように、本発明によれば、凹凸状情報を有する板状体の複製用金属母型が、正確な転写 パターンをもつものとして安定に得ることができ 次工程のために極めて良好な金属母型を提供する ことができる。

4. 図面の簡単な説明

図面は、本発明を実施する場合、円盤の内外周間の抵抗値の、無電解ニッケルメッキ時間に対する依存性を示す図表である。

代理人弁理士 中村純之助

〔実施例4〕

実施例1と同一の被着体に対する無電解ニッケルメッキをスプレイ法で検討した。液晶は 30 ℃、塗布時間は 3 分間であり、液の組成は次のとおりである。

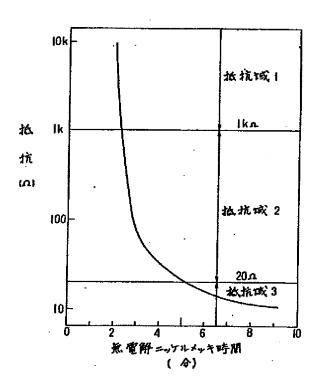
ニッケル故 : Ni Clo · 6Ho O

			50	g / e
		NH ₄ Cg	50	g / L
還元液	•	Na BH ₄	1	g / e
		Na O H	4	g / l
		р Н	1 2	

上記により得られた溥電性基層は、半透明で完全 な金属鏡面にはなっていない。内外周間の抵抗は 約40 g であった。次に、実施例1と同様に、電 解ニッケルメッキを行ったところ、実施例1と同様に良好であった。

〔比較例〕

実施例1と同様の検討を行い、無電解ニッケル メッキ帝の受債時間を8分間にしたところ、後段 のニッケルメッキ時に、平坦部のメッキ膜にクラ



第1頁の続き

⑩発 明 者 三輪広明

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内